


- ST1
- Trapezový plech 55/250 tl.0,75mm + laťování 40/60
  - Dřevěný vazník (prováděcí a výrobní dokumentace od dodavatele konstrukce, včetně statického posouzení)
  - Minerální izolace  $\lambda=0,039W/mK$  200mm
  - Minerální izolace  $\lambda=0,033W/mK$  50mm
  - (izolace  $\lambda=0,033W/mK$  s  $\rho=0,060kg/m^3$ ) izolace drátovaná
  - Křížový ocelový SDK rošt, zavěšený
  - Parozábrana (přetíženo přes stěny)
  - Perforace zamezena pomocí bitumenové pásky)
  - SDK tl.15mm 15mm

- Pozn.:
- konstrukce musí splňovat REI30
  - podhledy z SDK v místnostech číslo:
    - 1.03 až 1.15 SDK 15mm
    - 1.16 až 1.21 SDK 15mm impregnovaná do vlhkého prostředí
    - 1.22 až 1.24 SDK 15mm

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

Investor:	LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha 9 - Kbely k.ú.: Vysocňany p.č. 1725/14	Datum:	12/2018
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Supletí PD:	DSP_DPS
Zodp. projektant:	Ing. Radek Dědina	Část:	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ ČÁST
Vypracoval:	Lukáš Dědič, Ing. Michael Martin	Paré:	Formát: 2xA4
Akce:	<b>2. ETAPA MODERNIZACE HALY H53 - ČÁST VÝCHOD</b>	Měřtko:	1:10
Obsah:	<b>DETAIL SDK PODHLEDU</b>	Číslo výkresu:	D.1.2.11